

## 令和 03 年度 (後期) 技能検定 学科試験正解

## 半導体製品製造 / 集積回路チップ製造作業【1級】

## 真偽法

番号	1	2	3	4	5
正解	○	×	○	○	○

番号	6	7	8	9	10
正解	○	○	○	×	○

番号	11	12	13	14	15
正解	×	○	×	×	×

番号	16	17	18	19	20
正解	×	○	○	×	○

番号	21	22	23	24	25
正解	○	○	×	×	○

## 択一法

番号	1	2	3	4	5
正解	ニ	ハ	ニ	ハ	ハ

番号	6	7	8	9	10
正解	ニ	ハ	イ	ロ	イ

番号	11	12	13	14	15
正解	ハ	ロ	イ	ロ	ニ

番号	16	17	18	19	20
正解	イ	ハ	ハ	ニ	ニ

番号	21	22	23	24	25
正解	ロ	ハ	ハ	ロ	ロ